

H3C SR6600X-CMW520-R3303P03版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

表1 版本配套表

产品系列	SR6600-X系列
型号	SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
内存	RSE-X2: 4G FIP-110: 2G/4G FIP-210: 2G/4G FIP-240: 2G/4G FIP-300: 4G/4G FIP-310: 4G/4G FIP-600: 4G SAP-24GBP: 2G/4G SAP-48GBP: 2G/4G SAP-48GBE: 2G/4G SAP-4EXP: 4G
FLASH/CF卡	最小256M
BootWare版本号	随主机版本自动升级，本次版本加载之后： RSE-X2主控板将升级为1.04， SFE-X1将升级到1.02， FIP-110将升级到1.12， FIP-210将升级到1.07， FIP-240将升级到1.14， FIP-300将升级到1.06， FIP-310将升级到1.06， FIP-600将升级到1.14， SAP-24GBP、SAP-48GBP和SAP-48GBE将升级到1.06， SAP-4EXP将升级到1.14。
目标文件名称及MD5校验码	SR6600X-CMW520-R3303P03.bin: 92cfc5378559164dc11e5a9ce57601e1
iMC版本号	iMC EAD 7.0 (E0102) iMC EIA 7.0 (E0102) iMC NTA 7.0 (E0101) iMC PLAT 7.0 (E0102) iMC QoSM 7.0 (E0102) iMC UBA 7.0 (E0101) iMC SHM 7.0 (E0101) iMC MVM 7.0 (E0101) iMC IVM 7.0(E0101)
iNode版本号	iNode PC 7.0 (E0102)
备注	无

表2-产品单板配套表

单板型号	单板名称	硬件版本	逻辑版本
RSE-X2	主控单元RSE-X2(4G DDR3/1AU X/1CON/1GE Mgt/1CF/1USB)	VER. B	基本段：100 扩展段：100
SFE-X1	SR6616-X SFE-X1交换网板	VER. A	100
FIP-110	FIP-110灵活接口平台	VER. A	单板：200 固定2GE：300
FIP-210	FIP-210灵活接口平台	VER. C	单板：200 固定2GE：100
FIP-240	FIP-240灵活接口平台	VER. A	单板：100 固定2GE：300
FIP-300	FIP-300灵活接口平台	VER. B	100
FIP-310	FIP-310灵活接口平台	VER. A	100
FIP-600	FIP-600灵活接口平台	VER. B	单板：200 固定2GE：300
SAP-24GBP	24端口千兆以太网光接口模块(SFP)	VER. A	100
SAP-48GBP	48端口千兆以太网光接口模块(SFP)	VER. A	100
SAP-48GBE	48端口千兆电口以太网接口模块	VER. A	100

SAP-4EXP	4端口万兆以太网光接口模块 (SFP+)	VER. A	100
SPE-FWM-200	H3C SR6600 防火墙 200 业务处理引擎	VER. A	300
SPE-SSL-200	H3C SR6600 SSL VPN 200 业务处理引擎	VER. A	300
SPE-IPS-200	H3C SR6600 千兆入侵防御系统模块	VER. A	300
SPE-ACG-200	H3C SR6600 应用控制网关业务板模块	VER. A	300
HIM-8FE	8端口百兆以太网电口接口模块	VER. B	100
HIM-4GBE	4端口千兆以太网电口接口模块	VER. B	200
HIM-4GBP	4端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER. A	200
HIM-8GBE	8端口千兆以太网电口接口模块	VER. B	200
HIM-8GBP	8端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER. A	200
HIM-8GBP-V2	8端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-1EXP	1端口万兆以太网光接口模块(XFP)	VER. A	200
HIM-CL1P	1端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER. B	底板: 100 子卡: 200
HIM-CL2P	2端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER. B	底板: 100 子卡: 200
HIM-CLS1P	1端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-CLS2P	2端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-MSP2P	2端口OC-3c/STM-1c或1端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-MSP4P	4端口OC-3c/STM-1c或2端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-PS1P	1端口OC-48/STM-16 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-AL1P	1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-AL2P	2端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-RS2P	2端口OC-48c/STM-16c RPR接口卡	VER. A	100
HIM-TS8P	8端口OC-3c/OC-12c POS或GE光接口模块 (SFP)	VER. A	200
HIM-4G4P	4端口GE光接口+4端口OC-3c POS接口模块 (SFP)	VER. A	200

表3 主控和线卡配套表

主控和线卡类型	FIP-110	FIP-210	FIP-240	FIP-300	FIP-310	FIP-600
RSE-X2	√	√	√	√	√	√

表4 主控和业务处理引擎配套表

主控和业务处理引擎类型	SPE-FWM-200	SPE-SSL-200	SPE-IPS-200	SPE-ACG-200
RSE-X2	√	√	√	√

表5 主控/网板和机箱配套表

主控和机箱类型	SR6604-X	SR6608-X	SR6616-X
RSE-X2	√	√	√
SFE-X1	x	x	√ (仅能插在6号槽位)

二、版本使用限制及注意事项:

1. 注意事项一:

堆叠环境下, 两框版本不一致时, 不能使用全局reboot命令, 否则会出现reboot命令失败。为避免此情况, 需要使能版本自动升级, 使备框自动从主框同步版本, 或者单独重启备框, 按照正常版本升级方法对备框主控进行版本升级, 使备框和主框版本一致。

2. 注意事项二:

堆叠环境下，若FIP-110、SAP-48GBE、SAP-24GBP、SAP-48GBP、SFE-X1的BootWare版本低于特定版本，设备启动过程中小概率出现板卡无法正常启动的情况。详细版本号如下：

FIP-110 BootWare版本低于（不包括）1.12

SAP-48GBE BootWare版本低于（不包括）1.06

SAP-24GBP BootWare版本低于（不包括）1.06

SAP-48GBP BootWare版本低于（不包括）1.06

SFE-X1 BootWare版本低于（不包括）1.02

当问题发生时，热插拔出问题的板卡即可正常启动。

三、增减特性说明：

版本号	项目	描述
CMW520-R3303P03	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持配置IPv6扩展报文丢弃功能 支持Netstream流量监控增强项目和host-monitor 支持配置PPP链路质量监测功能
CMW520-R3303P01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	新增配置HDLC捆绑口负载分担方式为逐包 新增配置PPP计费统计扩展功能 添加关键字“retries”到命令timerhold 支持LC（联创）类型的Portal服务器
CMW520-R3303	硬件特性更新	无
	软件特性更新	添加关键字“group”到 display gdoiks 命令 新增配置GDOI KS 监听冗余备份报文的 UDP 端口号 新增配置发送GDOI KS冗余备份 Hello 报文的时间间隔和接收冗余备份 Hello 报文的 最大次数 新增配置GDOI KS重传冗余备份报文的 时间间隔和最大次数 禁止BGP路由策略自动生效 添加关键字“seconds”到 session persist acl命令
CMW520-R3302	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持CRCC类型的Portal服务器 新增SAP-4EXP板卡以太网接口二层模式切换配置
CMW520-E3301	硬件特性更新	无
	软件特性更新	灵活配置mpls报文的逐流、逐包模式功能
CMW520-E3201P03	硬件特性更新	CMW520-E3201P03版本新发布以下硬件： ? FIP-240 ? FIP-300 ? FIP-310 ? HIM-TS8P ? HIM-4G4P ? HIM-8GBP-V2
	软件特性更新	PE设备支持UDP Helper 在FTP Server功能下增加对IPv6的支持 抑制PPP链路学习对端路由 支持Group Domain VPN 添加关键字“ibgp”,“ebgp”到balance 命令 接口描述字符串长度增加到240个字符 SSH新增支持交互认证方式 三层Portal用户在线探测功能
CMW520-E3201	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持IRF特性 FIP-600支持VPLS
CMW520-R3103P01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3103	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持Password-Recovery功能
CMW520-R3101	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无

版本号	项目	描述
CMW520-E2706P05	硬件特性更新	CMW520-E2706P05版本新发布以下硬件： ? SR6604-X ? SR6608-X ? SR6616-X ? SR6602-X2 ? RSE-X2 ? SPE-X1 ? SAP-EXP ? SAP-48GBP ? FIP-600
	软件特性更新	无

四、相比前一版本解决问题列表：

1. 201401210277

? 问题现象：本端接口PPP协议状态仍为UP。

? 问题产生条件：SR66设备加入MP硬件捆绑的E1接口中，第一个UP的E1接口对应的对端E1接口Down，同时MP中其它E1有数据报文在收发。

2. 201401270245

? 问题现象：无法通过温度传感器实体获取温度。

? 问题产生条件：无。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C SR6600X-CMW520-R3303P03版本说明书》。